

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对翰博高新 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 30 日出具的《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1300 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 1,000 万股新股，每股发行价格 48.47 元，新股发行募集资金总额为人民币 48,470.00 万元，扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费用及其他等发行费用后，募集资金净额为人民币 44,118.40 万元。2020 年 7 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]32804 号验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

（三）单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	484,700,000.00
加：利息收入	2,222,530.85
减：手续费	3,337.26
减：发行费用及相关税费	43,076,000.00
减：募集资金累计使用金额	157,399,901.51
其中：补充流动资金	157,399,901.51

项 目	金 额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	286,443,292.08

### （三）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，重新修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

翰博高新及中信建投证券股份有限公司分别与兴业银行合肥屯溪路支行、华夏银行北京亦庄支行、华夏银行合肥经济技术开发区支行、中国建设银行合肥青年路支行、东莞银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行重庆两江分行、中国建设银行股份有限公司郫都支行和中国银行重庆北碚支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行北京亦庄支行	10291000002316900	-
2	中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	121,977,815.46
3	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	111674531230	46,451,038.68
4	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	113074526840	39,091,141.58
合 计			207,519,995.72

注：不含报告期内已注销账户或已签署终止协议的账户

## 二、募集资金基本情况

### （一）募集资金使用情况

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	484,700,000.00
减：发行费用（不含税）	40,637,735.85
减：募集资金累计使用金额	242,802,715.27
其中：本年金额	82,964,549.61

项 目	金 额
背光源智能制造及相关配套设施建设项目	23,338,817.96
有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目	-
重庆翰博显示科技有限公司背光模组及研发中心项目	33,731,262.00
重庆翰博研发中心项目	23,322,102.00
补充流动资金	2,572,367.65
加：利息收入扣除手续费净额	6,260,446.84
其中：本年金额	4,041,253.25
<b>2021年12月31日募集资金余额</b>	<b>207,519,995.72</b>

## （二）变更募投项目的资金使用情况

2021年3月26日、2021年4月13日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”不再进行，公司使用该部分募投资金投资“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目及重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”，详细情况参见公司于2021年3月29日披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-023）。

## （三）募集资金进行现金管理情况

2021年度，公司不存在募集资金进行现金管理的情形。

## 三、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，翰博高新在募集资金使用过程中存在将自有资金误转入募集资金账户情形，具体情况如下：

2021年1月19日，为支付工资进行公司内部资金调拨，因出纳操作失误，将本应从博讯光电兴业银行一般户转入博讯光电建设银行基本户的40万元，误转入博讯光电建设银行募集资金账户。公司发现上述募集资金账户和其他账户之间资金的错误划转后，于2021年1月20日将资金原路转回。

截至本核查出具之日，该事项已经得到解决，不存在占用募集资金用于非募集资金投资项目的情形，不存在损害投资者利益的情形。2021年，翰博高新按照相关法律、法

规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，除前述情形外，不存在其他募集资金使用及披露的违规情形。

#### **四、会计师对募集资金 2021 年度存放和使用情况的专项鉴证意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对翰博高新募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为翰博高新《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了翰博高新 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，翰博高新募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，除“三、募集资金使用及披露中存在的问题”中所列情形外，募集资金使用不存在其他违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对翰博高新募集资金使用与存放情况无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 魏乃平

魏乃平

韩勇

韩勇

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

